

导热硅胶垫片 Tc-Pad AP600 技术参考资料

1. 概述



Tc-Pad AP600 (5003) 导热衬垫将高导热性能与 顺应性完美结合，专门为利用缝隙传递热量的设计方案制作，能够填充缝隙，有效的将发热部位的热量传递到散热器上。这些材料以极小的压力与配合表面贴合，从而对配合部件产生很小或不会产生应力。

Tc-Pad AP600 (5003) 导热衬垫具有固有的胶粘特性，无需粘合层，同时覆盖住微观不平整的表面从而使配合部件充分接触而提高热传导效率。产品的厚度可以根据客户的需求而定制，还可以选择背胶或者单面粘性，便于使用。

命名规则: Tc-Pad AP600 (50 X X)

① ② ③ ④

- ① Tc-Pad AP600-导热软片总类
- ② -导热系数: 50 代表 5.0W/(m.k).....以此类推
- ③ -基材: 0-无基材, 1-玻纤基材 2-聚酰亚胺基材 3-聚苯酯基材 4-铝箔基材 5-导热绝缘片基材
- ④ -参考硬度: 0-shore 00 硬度 70 以上, 1-shore 00 硬度 65, 2-shore 00 硬度 55, 3-shore 00 硬度 45, 4-shore 00 硬度 40 以下

2. 特性

- ◆ 导热系数 5.0 W/m · K
- ◆ 极低的热阻，提高散热效果
- ◆ 高粘性表面，易于使用
- ◆ V-0 阻燃等级

3. 性能参数 (5003)

检测项目	参考标准	单位	数值
颜色外观	目测	/	灰色
厚度	ASTM D374	mm	0.5 to 10.0
导热系数	ASTM D5470	W/m · K	5.0±0.5
热阻	ASTM D5470	@ 1mm, 20 psi	0.27℃ · in ² /W 2.2℃ · cm ² /W
硬 度	ASTM D2240	Shore 00	45±5
阻燃特性	U. L.	/	94 V-0
耐压强度	ASTM D149	kV (@1mm)	≥6.0

体积电阻率	ASTM D257	$\Omega \cdot \text{cm}$	$\geq 1.0 \times 10^{11}$
比 重	ASTM D792	g/cm^3	3.25 ± 0.15
压缩形变 (%，指定压力)	ASTM D575	20psi	32
		40psi	37
		60psi	41
介电常数	ASTM D150	@1 MHz	5.0
连续使用温度	/	$^{\circ}\text{C}$	-60 to 200

4. 主要用途

- ◆ 台式机、便携式电脑和服务器
- ◆ LED 照明设备
- ◆ 电源和 UPS
- ◆ 电子通讯设备
- ◆ LCD 和 PDP 平板显示器
- ◆ 军用电子产品
- ◆ 马达和发动机控制器
- ◆ 能量转换设备

5. 包装

标准尺寸 470×470 mm，可根据顾客的需求裁切
0.50~10.0 mm 厚度可选
可依需求背胶

特别声明:

本说明所提供数据均为特定条件下测得，因使用环境的不同会略有差异；建议使用者在使用前预先测试，以确认是否适合使用目的；在使用过程中有任何问题，请与公司深圳总部联系。